

**PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA**

**N.º 3543**

*Para su comodidad, le ofrecemos la traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa únicamente a modo de referencia. Si desea conocer más detalles, consulte el texto original en inglés. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.*

*Consultas de los clientes*

Semiconductor & Device Marketing Div. B  
Mitsubishi Electric Corporation

[www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/](http://www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/)

*Consultas de los medios*

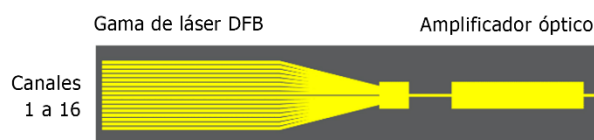
Public Relations Division  
Mitsubishi Electric Corporation

[prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp](mailto:prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp)

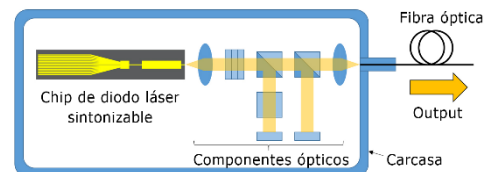
[www.MitsubishiElectric.com/news/](http://www.MitsubishiElectric.com/news/)

## **Mitsubishi Electric enviará muestras de chip de diodo láser sintonizable para la comunicación de fibra óptica**

*Aumentará la capacidad de comunicación digital coherente y reducirá el tamaño de los transceptores ópticos*



Chip de diodo láser sintonizable (imagen)



Ejemplo de aplicación del chip de diodo láser sintonizable

**TOKIO, 1 de septiembre de 2022** – [Mitsubishi Electric Corporation](https://www.mitsubishielectric.com) (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que el 1 de octubre comenzará a enviar muestras de su nuevo chip de diodo láser sintonizable para su uso en transceptores ópticos de sistemas de comunicación de fibra óptica. Se espera que el nuevo chip ayude a aumentar la capacidad de comunicación digital coherente, así como a reducir el tamaño de los transceptores ópticos.

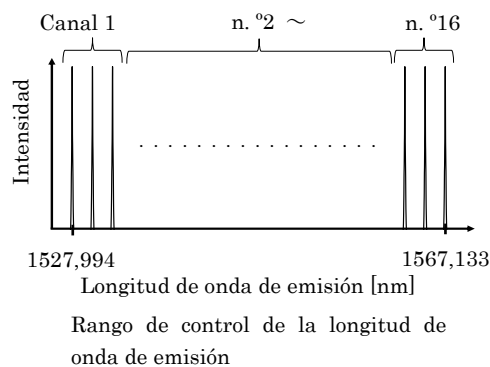
El volumen de comunicación de datos está aumentando rápidamente debido al uso cada vez más extendido de las redes de comunicación móvil 5G y a la popularización de los servicios de transmisión de vídeo. Como consecuencia, la capacidad de comunicación de alta velocidad debe aumentarse de los 100 Gbps actuales a 400 Gbps en redes de fibra óptica tanto para la comunicación entre centros de datos como para la comunicación a larga distancia. Por este motivo, ahora se están implementando sistemas de comunicación digital coherentes a fin de mejorar la eficiencia de las comunicaciones en las redes de fibra óptica. Al mismo tiempo, sin embargo, los transceptores ópticos deben ser de un tamaño más reducido para adaptarse a las limitaciones de espacio en los equipos de red, pero hasta ahora se han incorporado diodos láser sintonizables en los encapsulados, lo que dificulta la reducción de tamaño.

El nuevo chip produce una longitud de onda del espectro visible de luz de 1,55  $\mu\text{m}$  que se utiliza para la comunicación digital coherente. Además, admite un amplio rango de longitudes de onda según el estándar de transceptor óptico de 400 Gbps (OIF-400ZR-01.0). Presentar el producto en forma de chip ofrecerá a los fabricantes la flexibilidad necesaria para optimizar los diseños de encapsulados que requieren los transceptores ópticos específicos. El diseño altamente fiable del chip incorpora la tecnología de producción de semiconductores Mitsubishi Electric, desarrollada para la producción de láser de retroalimentación distribuida (DFB) en estaciones base móviles y de diodo láser integrado de modulador de electroabsorción (EML) en centros de datos.

### **Características del producto**

**1) *Admite un amplio rango de longitudes de onda para una comunicación digital coherente de mayor capacidad***

- La estructura consta de 16 láseres DFB con diferentes longitudes de onda de emisión dispuestos en paralelo para admitir un amplio rango de longitudes de onda.
- El control de temperatura permite cambios en la longitud de onda de aproximadamente 2,7 nm por canal, alcanzando longitudes de onda de emisión de 1,55  $\mu\text{m}$ , de 1527,994 nm a 1567,133 nm.
- Las características anteriores contribuirán a una comunicación digital coherente de mayor capacidad según el estándar OIF-400ZR-01.0 para transceptores ópticos.



**2) *La implementación del chip admite la reducción del tamaño de los transceptores ópticos***

- El montaje en forma de chip permite la estandarización con otros componentes ópticos, así como la colocación de componentes optimizada para diseños de encapsulado específicos, lo que ayuda a los fabricantes a reducir el tamaño de sus transceptores ópticos.

### **Desarrollo futuro**

Mitsubishi Electric tiene como objetivo la producción masiva del chip a partir de 2023. Además de los chips de diodo láser sintonizables, la empresa también está considerando desarrollar chips de modulador óptico para productos de 800 Gbps de última generación.

### **Especificaciones principales**

Modelo	ML9CP61
Salida óptica	17 dBm (típico.)
Rango de longitud de onda	1527,994 a 1567,133 nm
Dimensiones	0,75 x 3,8 x 0,1 mm (típico)
Envíos de muestras	Desde el 1 de octubre de 2022

### **Conciencia medioambiental**

El producto cumple con las directivas 2011/65/UE y (EU) 2015/863 sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS en inglés).

###

### **Acerca de Mitsubishi Electric Corporation**

Con más de 100 años de experiencia en el suministro de productos fiables y de alta calidad, Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) es un líder mundial reconocido en la fabricación, comercialización y venta de equipos eléctricos y electrónicos utilizados en el procesamiento de la información y las comunicaciones, en el desarrollo espacial y las comunicaciones por satélite, en los aparatos electrónicos de consumo, en la tecnología industrial, en la energía, en el transporte y en los equipos de construcción. A través del espíritu "Changes for the Better", Mitsubishi Electric se esfuerza por enriquecer la sociedad con tecnología. La empresa registró unos ingresos por valor de 4 191 400 000 de yenes (unos 37 800 millones de dólares estadounidenses\*) en el ejercicio fiscal finalizado el 31 de marzo de 2022. Si desea obtener más información, visite [www.MitsubishiElectric.com](http://www.MitsubishiElectric.com)

\*Las cantidades en dólares estadounidenses se han convertido a partir de yenes a un tipo de cambio de 122 yenes=1 dólar estadounidense, el tipo de cambio aproximado del mercado de divisas de Tokio a 31 de marzo de 2022